

導電碳膠

GF-2130 H

Conductive Paste GF-2130 H 是熱硬化的聚酯樹脂跟炭素粉及石墨粉混和的一液體的導電炭膠。尤其是針對 PET FILM 有良好的付著性。有穩定的阻抗值而適合用在軟片(Membrane) 及軟片上容易形成阻抗體。主要優點為低溫固化『 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 』軟片(Membrane)密著性, 饒曲性及表面硬度佳。適合用在要求硬度性能的插拔端子及導電回路的被覆用的材料之一

☆ 特 長

- : 用高沸點的溶劑而適當的配方, 不易揮發可適合在網版上連續印刷。
- : 碳粉及石墨粉的混合物分散在樹脂黏合劑, 印刷的體形可得到高精確度和穩定的電阻
- : 配方上使用的樹脂黏合劑可在低溫領域下, 有強壯的固化性。在『 $100^{\circ}\text{C} \times 30$ 分』固化條件
- : 下表面硬度有達到『 $\geq 2\text{H}$ 』, 形成的導電膜有良好的附著力。
- : 因為使用碳粉及石墨粉的混合物跟銀膠相容性好, 可使用在銀導電迴路上當導電的被覆材料

☆ 特 性

		GF-2130H	
外觀		中粘度黑色ペースト状態	
粘 度		200 ~ 300 dPa · s at 25°C	Viscotester VT-04F
硬化条件		80°C ~ 100°C × 30 分	Box 乾燥機
密 着 性		100 / 100 (PET Film)	Cross Cut · Peeling Test
表面 硬度	80°C X 30 分	$\geq 2\text{H}$	鉛筆硬度
	100°C X 30 分	$\geq 2\text{H}$	
面積 抵抗値	80°C × 30 分	120 ~ 135 Ω / \square	膜厚/10 μm
	100°C × 30 分	100 ~ 110 Ω / \square	
屈曲性 (阻抗變化率)		10% 以內	塗布側 / 180° 單面 / 5 回屈曲

* 上述數值為蔽司之研究實驗值, 而非保證數據

☆ 使用方法及取樣上的注意事項

- 請務必使用原樣品。若需要稀釋的話, 請使用專用稀釋劑「SM-20」。
- 使用前或添加稀釋劑之後, 請均勻攪拌後使用之。
- 塗佈之前請先務必清潔塗佈表面, 以免造成密著性及導電性下降。
- 塗佈時, 適合使用特多龍材質的網版(180 ~ 250 mesh)。 *最適膜厚 10 ~ 20 μm
- 欲清洗使用後之網版、治具及容器, 請使用丙酮溶劑(Acetone)及酯類(Ester)溶劑。
- 產品取樣時, 請務必穿著護具於抽氣良好之作業場所下操作之。
- 使用保存期限為 6 個月 (於 25°C 存放下)。



ASKMI Industries Limit

業務連絡: 邁拓企業股份有限公司 TEL: 02-2918-9913 胡麗華 (分機11)

E-mail: elizahu@selmag.com.tw Mobile : 0938-120-186